

## 2023年12月期 決算短信(日本基準)(連結)

2024年2月14日

上場会社名 ウィンテスト株式会社

上場取引所

東

コード番号 6721 URL <https://www.wintest.co.jp/>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 姜 輝

問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役

(氏名) 樋口 真康

TEL 045-317-7888

定時株主総会開催予定日 2024年3月27日

有価証券報告書提出予定日 2024年3月29日

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 有

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 2023年12月期の連結業績(2023年1月1日～2023年12月31日)

## (1) 連結経営成績

(％表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益	
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％
2023年12月期	407	93.7	558		552		554	
2022年12月期	210	31.6	693		683		686	

(注) 包括利益 2023年12月期 520百万円 (％) 2022年12月期 652百万円 (％)

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産経常利益率	売上高営業利益率
	円 銭	円 銭	％	％	％
2023年12月期	13.85		37.0	28.5	137.1
2022年12月期	19.87		46.9	36.0	329.7

(参考) 持分法投資損益 2023年12月期 百万円 2022年12月期 百万円

(注) 2022年12月期及び2023年12月期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	％	円 銭
2023年12月期	1,973	1,665	83.9	37.94
2022年12月期	1,902	1,352	70.6	37.24

(参考) 自己資本 2023年12月期 1,655百万円 2022年12月期 1,343百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー	投資活動によるキャッシュ・フロー	財務活動によるキャッシュ・フロー	現金及び現金同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
2023年12月期	558	0	641	361
2022年12月期	613	3	667	278

## 2. 配当の状況

	年間配当金					配当金総額 (合計)	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計			
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	％	％
2022年12月期		0.00		0.00	0.00			
2023年12月期		0.00		0.00	0.00			
2024年12月期(予想)		0.00		0.00	0.00			

## 3. 2024年12月期の連結業績予想(2024年1月1日～2024年12月31日)

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する 当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	％	百万円	％	百万円	％	百万円	％	円 銭
第2四半期(累計) 通期									

\* 2024年12月期の連結業績予想につきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示します。詳細については、添付資料P3「1. 経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。

注記事項

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無

新規 社 (社名) 、 除外 社 (社名)

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有  
 以外の会計方針の変更 : 無  
 会計上の見積りの変更 : 無  
 修正再表示 : 無

(注)詳細は、添付資料P16「3. 連結財務諸表及び主な注記(5) 連結財務諸表に関する注意事項(会計方針の変更)」をご覧ください。

(3) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年12月期	43,641,000 株	2022年12月期	36,072,000 株
期末自己株式数	2023年12月期	株	2022年12月期	株
期中平均株式数	2023年12月期	40,029,819 株	2022年12月期	34,532,427 株

(参考)個別業績の概要

2023年12月期の個別業績(2023年1月1日～2023年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年12月期	286	21.4	496		498		500	
2022年12月期	236	7.2	542		546		549	

	1株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
2023年12月期	12.50	
2022年12月期	15.90	

(注)2022年12月期及び2023年12月の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載していません。

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円 銭	円 銭	
2023年12月期	2,223	1,984	1,984	1,652	88.9	45.27	45.27	
2022年12月期	2,058	1,652	1,652	1,652	79.8	45.54	45.54	

(参考) 自己資本 2023年12月期 1,975百万円 2022年12月期 1,642百万円

決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束するものではありません。実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご了解ください。また上記予想の前提条件、その他関連する事項については、添付資料3ページ「1. 経営成績等の概況(4) 今後の見通し」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 経営成績等の概況 .....	2
(1) 当期の経営成績の概況 .....	2
(2) 当期の財政状態の概況 .....	3
(3) 当期のキャッシュ・フローの概況 .....	3
(4) 今後の見通し .....	3
(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 .....	5
(6) 継続企業の前提に関する重要事象等 .....	5
2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方 .....	6
3. 連結財務諸表及び主な注記 .....	7
(1) 連結貸借対照表 .....	7
(2) 連結損益計算書及び連結包括利益計算書 .....	9
連結損益計算書 .....	9
連結包括利益計算書 .....	10
(3) 連結株主資本等変動計算書 .....	11
(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 .....	13
(5) 連結財務諸表に関する注記事項 .....	14
(継続企業の前提に関する注記) .....	14
(会計方針の変更) .....	16
(連結損益計算書関係) .....	17
(セグメント情報等) .....	18
(1株当たり情報) .....	20
(重要な後発事象) .....	21

## 1. 経営成績等の概況

### （1）当期の経営成績の概況

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染抑制の措置やそれに伴う行動制限が緩和され、コロナ後の新しい社会への対応が進んだことで、需要と供給の両面において堅調に回復しています。半導体をはじめとする電子部品や材料等供給の国際的ひっ迫による厳しい状況が続きましたが、影響は軽減してきています。一方、ロシアによるウクライナ侵攻等の地政学リスクや、米国におけるインフレ抑制のための金利の引上げ、中国経済の減速懸念など、経済の先行き不透明感が残りました。

WSTS（World Semiconductor Trade Statistics／世界半導体市場統計）によれば、2023年の世界半導体市場規模は、前年比9.4%減の5201億2600万米ドルと、4年ぶりのマイナス成長となりました。2023年前半は、2022年後半から続く民生半導体のダブつきによる下押し要因によって、メモリーをはじめとして大半の半導体部材、製品の受注はマイナス成長となりました。テレワーク需要の終息等の影響によりダブつきの解消は遅れ、2023年の後半まで継続いたしました。その影響は、半導体工場の生産調整にまで及び、製造装置稼働率は大きく低下し、新規設備投資の抑制から受注分については納期調整要求や新規受注がストップする事態となりました。そのため、2023年2月14日発表の「2022年12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の中で開示した連結業績予想13億円の売上は、達成不可能となり、2023年11月14日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」を開示し、連結業績予想5.2億円と予想を変更したものの、2023年12月に受注・売上予定であった一部の受注が2024年1月15日に持ち越したため、2023年の受注・売上は2023年11月14日付の開示の業績予想を下回ることになり、2024年2月14日付で「通期連結業績予測と実績値との差異及び個別実績値と前期実績値との差異に関するお知らせ」を開示することとなりました。

当社グループが属する半導体市場の2024年度の状況としては、WSTSの予測によると前年比13.1%増の5,883億6,400万米ドルと市場が再拡大し、過去最高だった2022年の5740億8400万米ドルを上回るとしています。生成AI関連やパワーディスクリートの需要の継続成長が見込める他、2024年からは景気回復への期待を念頭に、電子機器全般の需要が拡大すると想定されています。

上述のような経済状況のなか、製造工場の新規設備投資は、前年度より改善いたしましたでしたが、2023年度末まで大きく抑制された状況が続きました。当初の予定では2023年半ばには市場における民生用半導体のダブつきの解消や半導体製造工場の稼働率の改善及び新規設備投資再開を見込んでおりましたが、2023年度末までに市場の改善は見られず、当社検査装置を使用する見込先の工場の稼働率が引続き低迷、新規設備投資は2024年度に見送られる形となりました。結果、当社の事業活動は大きな影響を受け、追加受注、売上時期は2024年度以降となりました。2023年末までに予定していたLCDドライバーIC検査装置の受注売上は2024年以降に持ち越しとなりました。

2023年の表示デバイス市場は、成長率において増加は少なかったものの（前年対比2%程度）、ディスプレイサ―チ社並びにOmdia社の見解では、2024年には本格的な回復が見込まれているとされ、市場は、3年前の1377億ドルから、2024年には1677億ドルへと大きく伸長すると予測されています。加えて2023年から2030年にかけて、32.5%のCAGR（年平均成長率）を記録すると予想しており、市場は継続的に伸長するとされています。

当社は2023年において、ディスプレイドライバーIC検査装置の開発に注力いたしました。2023年中に複数の次世代検査装置オプションを開発完成させリリースを行いました。新開発した次世代機能の一部については、既にいくつかの顧客製造現場においてベンチマークを終了しており、2024年の当社ビジネスの推進並びに開発中のWTS-9000C/Sの主軸機能となり、2024年の半導体の波に乗るための強力な事業推進ツールとなる予定です。

今後も武漢精測グループの一員として、横浜本社、大阪事業所における開発環境整備と人材育成に努め組織の強化を行い、各部署の業務推進体制を革新するため、ERPやITを駆使したより機動的かつ最新の環境で、設計、開発及び経営能力を強化するとともに、トータルコストの削減、納期の短縮と品質の向上を目指し、顧客満足度を上げることで受注増、業績の向上、企業価値の増大を図り、株主様の利益につなげてまいります。

以上のような世界経済の状況、市場及び顧客製造工場の投資戦略状況など厳しい状況が続き、当社の当連結会計年度の売上高は407,449千円と前期より増加し回復基調にあるものの、営業損失は558,459千円、経常損失は552,095千円、親会社株主に帰属する当期純損失は554,572千円となりました。

なお、セグメント区分については、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、当連結会計年度より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を2022年8月末付にて、株式会社データゲート（大阪府大阪市北区）に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったためであり、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

(2) 当期の財政状態の概況

(資産)

当連結会計年度末における流動資産は1,949,076千円となり、前連結会計年度末に比べ71,775千円の増加となりました。これは主に現金及び預金が83,185千円増加したことによるものです。

固定資産は24,588千円となり、前連結会計年度末に比べ354千円の減少となりました。これは主に投資その他の資産が354千円減少したことによるものです。

(負債)

当連結会計年度末における流動負債は164,831千円となり、前連結会計年度末に比べ208,903千円の減少となりました。これは主に短期借入金が157,030千円減少したことによるものです。

固定負債は143,651千円となり、前連結会計年度末に比べ32,140千円の減少となりました。これは主に長期借入金返済により32,064千円減少したことによるものです。

(純資産)

当連結会計年度末における純資産は1,665,183千円となり、前連結会計年度末に比べ312,465千円の増加となりました。これは、親会社株主に帰属する当期純損失により利益剰余金が554,572千円減少したものの、新株予約権の行使及び新株の発行により資本金及び資本剰余金が各々416,629円増加したことによるものです。

(3) 当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は361,665千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果減少した資金は558,267千円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失が552,095千円となったことによるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は300千円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出が300千円あったことによるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果増加した資金は641,025千円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出が159,998千円あったものの、新株予約権の行使による株式の発行による収入が428,424千円あったこと及び株式の発行による収入が399,921千円あったことによるものです。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

	2020年7月期	2020年12月期	2021年12月期	2022年12月期	2023年12月期
自己資本比率 (%)	86.1	88.3	83.4	70.6	83.9
時価ベースの自己資本比率 (%)	220.0	378.2	329.3	235.1	203.4
キャッシュ・フロー対有利子負債比率 (年)	—	—	—	—	—
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)	—	—	—	—	—

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注) 1. 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

2. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

3. 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。

4. 2020年7月期、2020年12月期、2021年12月期、2022年12月期及び2023年12月期は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(4) 今後の見通し

上述のとおり、半導体業界及び半導体検査装置業界は、需要が拡大しつつあります。しかしながら、2023年の実

績を鑑みますと、市場の動向及び顧客の新規設備投資の予測を、現時点で正確に見定めることは非常に困難であると判断いたしました。通期の業績見通しにつきましては、開示が可能となった時点で速やかに開示することとさせていただきます。

#### ①主たる既存事業への取り組み

##### ア. 検査装置機能の高速化及び機能性向上

当社グループの主要事業である半導体検査装置事業では、高度化、多様化するお客様の検査ニーズにお応えするため、既存検査技術の革新を進め、高速パターン発生機などの次世代機能の開発を継続、それらの機能の一部を現行装置WTS-577SRに先行搭載し、各お客様工場で新しくリリースされる新製品向け半導体チップに対する検査手法の提供とベンチマークを継続しお客様との関係づくりに奔走してまいりました。

さらに足元の計画として、製造能力の強化と品質管理体制の整備推進をととして、お客様にとってより信頼される企業として成長するために、以下の課題への取り組みを進めてまいります。

当社の主たる事業分野である半導体検査装置事業分野はスマートフォンに代表されるように新製品サイクルが非常に早く、おおよそ、6か月を目途として新製品がリリースされ、その技術レベルや機能レベルが上がるごとに新機能を実現するための「新開発半導体チップ」が要求され開発されています。そのため、当社グループとしては、開発部門による検査装置自体の開発の手を緩めることなく、加えて応用技術部門では、市場要求（新開発半導体チップ）に合わせた新機能を検査する手法の開発と多角的な検査のアプローチ方法を提案、ベンチマークを行い、より検査の幅を厚くする取り組みを続けてまいります。

半導体検査装置においては高精度、低コスト、高速化に加え信頼性の向上が求められるだけでなく、更に使いやすいUI(ユーザーインターフェース)と、検査を補助する機能の強化を実現する必要があります。それぞれをこれまでにないスピードで推し進めることが同分野において求められることから、引続き組織と業務運営体制の整備を進め、よりスピーディーな開発判断ができるように改革を行ってまいります。

当社がメインマーケットとしている中国の経済情勢に関しては、新聞報道などで不動産投資関連による経済破綻などが取り上げられておりますが、半導体に関しましては、世界的に見ても中国を抜きに語れないのが現実です。当社は引き続き、中国と台湾をメインマーケットとし、現地顧客のニーズを把握し当社100%出資の中国湖北省武漢市に設立した偉恩測試技術(武漢)有限公司(以下、「ウインテスト武漢」という)の能力を最大限に高め、製造から納品までのタイムラグをなくすことで、現地顧客の信頼、ニーズを先取りした経営を行ってまいります。

##### イ. 営業力強化・顧客サポートの充実

当社は、ウインテスト武漢の開発部の能力を生かし、従来機を中心に新機能や高速化を目的とした開発や改良を行い、製造品質の強化に努め、また販売においては蘇州に販売拠点を設けて営業部の拡充を進めております。ウインテスト武漢の営業部及び日本、台湾における販売店との連携を強化、全販売拠点協働で新規顧客へのアプローチ、既存顧客からのレポート受注の促進を図ってまいります。

#### ②新規事業による事業の多角化への取り組み

当社は、業績の改善と受注の増加を目指し、既存の半導体検査装置事業に隣接する事業に関しても事業展開をしております。その一環として、産学連携を行っております。

検査装置向け工場FA化機器技術(「自重補償機構技術」)、当該技術については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については終了しております。当社は、当該技術により、当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター(以下「ポゴタワー」という。)の着脱(約25kg~30kg)をオペレーターひとりで簡単に安全に行うための補助アーム(以下「マニピュレータ」という。)を製品化しようと考えており、ロボットを得意とする専門工場に依頼し量産製造の準備を行っております。その後、「物流の2024年問題」として社会問題化されております物流搬送市場におけるトラック向け補助装置への応用製品化を目指しております。

奈良県立大学と進めております脈波(BCG, ECG)を利用したヘルスケア管理システムは、現在特定のお客様への試験販売を継続しつつ同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し機能の強化を進めており、当面は病院、介護施設への販売をいたします。

水素ナノバブルイオン洗浄水に関しましては、装置製造元と提供方法について協議を続けてまいりましたが、装置の大幅な小型化に成功したことにより、小規模BtoBまたは、BtoC向けとしては、装置単体の販売を計画し、また大規模BtoB向けには、装置のレンタルを含む販売を計画しております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。

(注) インダストリー4.0 検査装置向け工場FA化機器技術に使われる「自重補償機構技術」とは

一般的な「重量物搬送装置」は、電気モーターやエンジン等の動力源を持ち、かつ、重いカウンターウェイトや油圧・圧縮空気の出力を借りることで、数十キロから数百キロの重量物の移動をアシストしますが、装置が大掛りで重量が重くなることや、重量物に見合う外部動力が必要となるといった課題を有しています。これらの課題克服

のため、当社と慶應義塾先端科学技術研究センターは、いかなる動力や重いカウンターウエイト、そして油圧・空圧機器をも使用しない「自重補償機構」の開発を進め、バネの弾性力を応用した軽量かつシンプルな構造を内蔵したロボットアームの継続開発を行っております。今般開発した試作機は、被搬送物の重量が変化した場合でもその重さに見合った自重補償ができる構造となっており、回転軸を除く各軸にて搬送する重量物の自重補償を達成し、自身の腕部分の自重をも含め、より安全な自重補償を成立させています。

（5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社グループは、「株主に対する利益還元」を経営課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主利益向上に努めるとともに、配当につきましても、業績に応じ安定的な配当の継続を行うことを基本方針としております。しかしながら、企業体質の強化や競争力の維持及び今後の事業展開を行うには安定的な資金確保が必要となります。そのため、内部留保に重点を置いた方針を実施することもあります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に技術やコスト競争力を高め、市場ニーズに応える製品の開発体制を強化し、また、営業分野における海外での活動を展開するための原資として備えたいと考えております。

なお、当社グループは期末配当に加え、取締役会の決議により毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に規定し、年2回の剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当連結会計年度の配当につきましては、業績並びに厳しい経営環境を鑑み、誠に遺憾ながら引続き無配とさせていただきます。

（6）継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、半導体市場の減速の影響により、前連結会計年度における売上高は210,315千円となり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。なお、営業キャッシュ・フローは、613,481千円のマイナスとなりました。

当連結会計年度における半導体検査装置業界は、2022年後半から続く民生半導体の過剰在庫によるダブつきによる下押し要因によって、メモリーをはじめとして大半の半導体部材、製品の出荷はマイナス成長となりました。WSTSなどのアナリストの予測によると、半導体の過剰在庫解消は、当初2023年度半ばには解消されるとのことでしたが、予測は大きくずれ込み、期待されたダブつき解消は、2023年末まで引きずる形となりました。その結果、製造工場は生産調整を余儀なくされ工場製造装置稼働率は大きく低下、2023年度は、新規設備投資の見送りを決める製造工場が多く、当社においても納期調整要求や新規受注見送り等の影響が出る状況となりました。以上の状況は、当社グループの事業活動に大きく影響し、予定していた追加受注及び売上は一部において2024年以降となりました。

以上より、当連結会計年度の売上高は、407,449千円と前期より増加し回復基調にあるものの、営業損失は558,459千円となり、親会社株主に帰属する当期純損失を554,572千円計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、558,267千円のマイナスとなりました。

上述のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく対応策に取り組んでおりますが、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

なお、継続企業の前提に関する事項及びその対応策に関しましては、「3. 連結財務諸表及び主な注記（5）連結財務諸表に関する注記事項（継続企業の前提に関する注記）」に記載しております。

## 2. 会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表を作成する方針であります。なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。



## 3. 連結財務諸表及び主な注記

## (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	278,480	361,665
売掛金	21,058	106,452
電子記録債権	21,670	2,433
商品及び製品	215,344	118,278
仕掛品	797,167	813,622
原材料及び貯蔵品	506,251	525,733
前渡金	8,677	4,094
未収消費税等	13,270	5,561
その他	15,381	11,234
流動資産合計	1,877,301	1,949,076
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,182	8,182
減価償却累計額	△8,182	△8,182
建物（純額）	—	—
車両運搬具	8,885	8,885
減価償却累計額	△8,885	△8,885
車両運搬具（純額）	—	—
工具、器具及び備品	181,952	181,952
減価償却累計額	△181,952	△181,952
工具、器具及び備品（純額）	—	—
有形固定資産合計	—	—
投資その他の資産		
その他	27,827	24,588
貸倒引当金	△2,884	—
投資その他の資産合計	24,943	24,588
固定資産合計	24,943	24,588
資産合計	1,902,244	1,973,665

（単位：千円）

	前連結会計年度 (2022年12月31日)	当連結会計年度 (2023年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	21,750	12,077
短期借入金	157,030	—
1年内返済予定の長期借入金	32,064	32,064
未払金	75,020	52,286
未払法人税等	10,689	13,959
契約負債	45,696	3,303
製品保証引当金	300	552
その他	31,183	50,587
流動負債合計	373,734	164,831
固定負債		
長期借入金	169,030	136,966
リース債務	343	171
資産除去債務	6,418	6,513
固定負債合計	175,791	143,651
負債合計	549,526	308,482
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,210,563	1,627,193
資本剰余金	1,497,050	1,913,679
利益剰余金	△1,468,555	△2,023,127
株主資本合計	1,239,059	1,517,745
その他の包括利益累計額		
為替換算調整勘定	104,158	138,203
その他の包括利益累計額合計	104,158	138,203
新株予約権	9,500	9,234
純資産合計	1,352,717	1,665,183
負債純資産合計	1,902,244	1,973,665

（2）連結損益計算書及び連結包括利益計算書  
（連結損益計算書）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）	当連結会計年度 （自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）
売上高	210,315	407,449
売上原価	148,156	256,025
売上総利益	62,158	151,423
販売費及び一般管理費	755,660	709,883
営業損失（△）	△693,502	△558,459
営業外収益		
受取利息	85	59
為替差益	11,304	13,271
補助金収入	3,763	—
その他	1,003	1,283
営業外収益合計	16,157	14,614
営業外費用		
支払利息	4,727	5,435
支払手数料	—	2,112
その他	1,691	702
営業外費用合計	6,419	8,250
経常損失（△）	△683,764	△552,095
税金等調整前当期純損失（△）	△683,764	△552,095
法人税、住民税及び事業税	2,476	2,476
法人税等還付税額	—	—
法人税等合計	2,476	2,476
当期純損失（△）	△686,241	△554,572
親会社株主に帰属する当期純損失（△）	△686,241	△554,572

（連結包括利益計算書）

（単位：千円）

	前連結会計年度 （自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）	当連結会計年度 （自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）
当期純損失（△）	△686,241	△554,572
その他の包括利益		
為替換算調整勘定	33,724	34,044
その他の包括利益合計	33,724	34,044
包括利益	△652,516	△520,528
（内訳）		
親会社株主に係る包括利益	△652,516	△520,528
非支配株主に係る包括利益	—	—

（3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	1,000,000	1,286,486	△775,689	1,510,797
会計方針の変更による累積的影響額			△6,624	△6,624
会計方針の変更を反映した当期首残高	1,000,000	1,286,486	△782,313	1,504,172
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△686,241	△686,241
新株の発行	210,563	210,563		421,127
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	210,563	210,563	△686,241	△265,113
当期末残高	1,210,563	1,497,050	△1,468,555	1,239,059

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	70,434	70,434	9,196	1,590,428
会計方針の変更による累積的影響額				△6,624
会計方針の変更を反映した当期首残高	70,434	70,434	9,196	1,583,803
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）				△686,241
新株の発行				421,127
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	33,724	33,724	304	34,028
当期変動額合計	33,724	33,724	304	△231,085
当期末残高	104,158	104,158	9,500	1,352,717

当連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

（単位：千円）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
当期首残高	1,210,563	1,497,050	△1,468,555	1,239,059
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）			△554,572	△554,572
新株の発行	416,629	416,629		833,259
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）				
当期変動額合計	416,629	416,629	△554,572	278,686
当期末残高	1,627,193	1,913,679	△2,023,127	1,517,745

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産合計
	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	104,158	104,158	9,500	1,352,717
当期変動額				
親会社株主に帰属する当期純損失（△）				△554,572
新株の発行				833,259
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	34,044	34,044	△266	33,778
当期変動額合計	34,044	34,044	△266	312,465
当期末残高	138,203	138,203	9,234	1,665,183

（4）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純損失（△）	△683,764	△552,095
貸倒引当金の増減額（△は減少）	—	△2,884
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△1,607	252
受取利息及び受取配当金	△85	△59
支払利息	4,727	5,435
為替差損益（△は益）	△122	0
売上債権の増減額（△は増加）	△6,211	△66,162
棚卸資産の増減額（△は増加）	5,498	115,245
前渡金の増減額（△は増加）	2,744	4,658
仕入債務の増減額（△は減少）	△77,570	△16,919
未払又は未収消費税等の増減額	32,147	7,709
その他	103,106	△45,594
小計	△621,137	△550,414
利息及び配当金の受取額	85	59
利息の支払額	△3,439	△5,435
法人税等の支払額	△848	△2,477
法人税等の還付額	11,858	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	△613,481	△558,267
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
無形固定資産の取得による支出	—	△300
その他	3,880	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,880	△300
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（△は減少）	158,158	△159,998
長期借入れによる収入	120,000	—
長期借入金の返済による支出	△28,890	△32,064
リース債務の返済による支出	△855	△171
新株予約権の発行による収入	3,625	4,914
新株予約権の行使による株式の発行による収入	417,642	428,424
株式の発行による収入	—	399,921
その他	△1,696	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	667,984	641,025
現金及び現金同等物に係る換算差額	986	727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	59,370	83,185
現金及び現金同等物の期首残高	219,109	278,480
現金及び現金同等物の期末残高	278,480	361,665

## （5）連結財務諸表に関する注記事項

## （継続企業の前提に関する注記）

当社グループは、半導体市場の減速の影響により、前連結会計年度における売上高は210,315千円となり、営業損失693,502千円、親会社株主に帰属する当期純損失686,241千円を計上いたしました。なお、営業キャッシュ・フローは、613,481千円のマイナスとなりました。

当連結会計年度における半導体検査装置業界は、2022年後半から続く民生半導体の過剰在庫によるダブつきによる下押し要因によって、メモリーをはじめとして大半の半導体部材、製品の出荷はマイナス成長となりました。WSTSなどのアナリストの予測によると、半導体の過剰在庫解消は、当初2023年度半ばには解消されるとのことでしたが、予測は大きくずれ込み、期待されたダブつき解消は、2023年末まで引きずる形となりました。その結果、製造工場は生産調整を余儀なくされ工場製造装置稼働率は大きく低下、2023年度は、新規設備投資の見送りを決める製造工場が多く、当社においても納期調整要求や新規受注見送り等の影響が出る状況となりました。以上の状況は、当社グループの事業活動に大きく影響し、予定していた追加受注及び売上は一部において2024年以降となりました。

以上より、当連結会計年度の売上高は、407,449千円と前期より増加し回復基調にあるものの、営業損失は558,459千円となり、親会社株主に帰属する当期純損失を554,572千円計上しております。また、営業キャッシュ・フローは、558,267千円のマイナスとなりました。

上述のとおり、継続的な営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスが発生している状況にあり、当社グループには継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループはこうした状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を継続して実施しております。

## 事業施策

## 1. 中国国内での受注販売活動の促進

上述のように、当連結会計年度の半導体業界は、過剰在庫を十分に解消できておりません。その結果、OSAT（「Outsourced Semiconductor Assembly and Test」の略で、半導体の組立やテストといったいわゆる半導体製造の後工程を専門とする企業のことを言います。）は、薄型パネルを含めたPC等の組立用半導体部材の在庫調整を急ぐデザインハウスの計画修正を受ける形で設備投資を抑制しており、市場は2023年度の新規設備投資を控え、2024年度予算に組入れる様相です。しかし、2024年以降の半導体市場は、中長期的に見ますと、各国政府の進めるDX（デジタルトランスフォーメーション）のさらなる進展や脱炭素化推進に向けた取り組み、自動運転や5G、6Gなどの高速通信環境がもたらす新しいイノベーション、特にChatGPTに代表されるA. I. 技術の台頭が大きく取上げられ、対応する半導体を含め、新しい技術が急速に開発・開拓され、広範な需要に支えられ伸長するものと想定されております。

当社グループが「主力装置」と位置付けるLCDドライバIC検査装置は、液晶パネルに使われるLCDドライバICの検査に使用されており、また、それら情報端末ではLCDドライバICだけではなく、当社が得意とするCMOSイメージセンサーIC、ロジックICなど周辺半導体デバイスの需要も大きな伸びが期待される分野です。当社の主力検査装置WTS-577SRにつきましては、2021年から販売を開始し、装置の貸出しを伴うベンチマークに積極的に取り組み、お客様から量産ラインへの投入評価をいただくことができました。新規の引合は前年度より伸びつつあるものの、上述の半導体業界の状況から、工場の稼働は未だ本格化しておらず、受注済みの装置を含む受注・出荷・売上並びに、国内顧客からの新規受注は、一部において設備投資が再開される2024年を予定しております。

今後、当社連結子会社の偉恩測試技術(武漢)有限公司（以下、「ウインテスト武漢」という。）との協力体制強化を土台にし、武漢精測グループ並びに台湾代理店との協力関係を推し進め、営業活動を見直してまいります。さらに、ウインテスト武漢においては、コストの削減と顧客対応力の両方を強化、更なる最終組立工程の製造品質の向上に取り組み、中国国内市場への深耕を図ってまいります。

## 2. 技術開発の強化

先端ロジックIC検査装置（1024チャンネル、875Mbps）に関しては、国内、台湾、中国顧客向けを想定した開発を継続しており、多くの部分を現在開発中の次世代LCDドライバー検査装置と共用することで、より広範囲のロジックIC検査に対応できるように計画し、協力企業とともに2024年にベンチマークを終了する予定です。

また、新たな収益の柱を構築するための成長戦略として、2025年までに当社グループがこれまで培ってきた検査技術や画像処理技術、高精度センサー技術及びデータ解析技術を応用しつつ外部専門会社と協力し、今後の市場拡大が見込まれる5Gとその後の6G通信規格の台頭とともに注目を集めるパワーデバイス検査分野への進出を目指し、M&Aなども視野にシナジーの高い事業会社との資本・業務提携を積極的に進めることにより、当該分野への新規参入及び対応可能検査範囲の拡充と展開を図ることで、収益基盤の拡充に取り組んでまいります。

## 3. 隣接領域の展開と製品化



検査装置向け工場FA化機器技術（「自重補償機構技術」）、当該技術については、学校法人慶應義塾大学慶應義塾先端科学技術研究センターと共同開発を進めており、特許等の申請については終了しております。当社は、当該技術により、当社の検査装置とウエーハ搬送装置との間のドッキングアダプター（以下「ポゴタワー」という。）の着脱（約25kg～30kg）をオペレーターひとりで簡単に安全に行うための補助アーム（以下「マニピュレータ」という。）を製品化しようと考えており、ロボットを得意とする専門工場に依頼し量産製造の準備を行っております。その後、「物流の2024年問題」として社会問題化されております物流搬送市場におけるトラック向け補助装置への応用製品化を目指しております。

奈良県立大学と進めております脈波（BCG, ECG）を利用したヘルスケア管理システムは、現在特定のお客様への試験販売を継続しつつ同大学並びに株式会社TAOS研究所とアライアンスを継続し機能の強化を進めており、当面は病院、介護施設への販売をいたします。

水素ナノバブルイオン洗浄水に関しましては、装置製造元と提供方法について協議を続けてまいりました結果、装置の大幅な小型化に成功したことにより、小規模BtoB又はBtoC向けとして、装置単体の販売を計画し、また大規模BtoB向けには装置のレンタルを含む販売を計画しております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。

（注）インダストリー4.0 検査装置向け工場FA化機器技術に使われる「自重補償機構技術」とは

一般的な「重量物搬送装置」は、電気モーターやエンジン等の動力源を持ち、かつ、重いカウンターウエイトや油圧・圧縮空気の出力を借りることで、数十キロから数百キロの重量物の移動をアシストしますが、装置が大掛りで重量が重くなることや、重量物に見合う外部動力が必要となるといった課題を有しています。これらの課題克服のため、当社と学校法人慶應義塾先端科学技術研究センターは、いかなる動力や重いカウンターウエイト、そして油圧・空圧機器をも使用しない「自重補償機構」の開発を進め、バネの弾性力を応用した軽量かつシンプルな構造を内蔵したロボットアームの継続開発を行っております。今般開発した試作機は、被搬送物の重量が変化した場合でもその重さに見合った自重補償ができる構造となっており、回転軸を除く各軸にて搬送する重量物の自重補償を達成し、自身の腕部分の自重をも含め、より安全な自重補償を成立させています。

#### 財務施策

財務面については、財務基盤の安定化を図るために、2023年1月13日開催の取締役会において、GFA株式会社を割当先とする第三者割当による新株予約権の発行を決議し、2023年6月21日までに新株予約権によって430,088千円の資金調達を実施いたしました。また、同目的のために、2023年9月15日開催の取締役会において、楽言海外国際（香港）有限公司を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2023年10月19日までに399,921千円の資金調達を実施いたしました。

これにより、今後の半導体検査装置事業に必要な中国における生産拠点整備資金及び次世代テストシステム等の開発資金、運転資金並びに新規事業の展開資金を確保いたしました。しかし、新株予約権行使による資金調達が、昨今の株価低迷により当初計画した調達予定額に達しなかったこと、上述のとおり新規設備投資の遅れが想定より長期にわたったことから、売上及び入金是一部翌期に持ち越しとなり、運転資金となる現預金が計画より減少することとなりました。今後の財務基盤の強化については、筆頭株主である武漢精測と諮りながら、同社グループ及び金融機関からの資金調達の施策を継続して実施してまいります。

以上の施策をもって抜本的な改善をしていく予定ですが、2023年中に起きた、半導体市場の生産調整などから、設備投資の大幅な抑制という事態になり、当社がメイン市場とする中国での受注並びに受注済み検査装置の出荷・売上の一部は、新規設備投資が再開される、2024年度以降となります。

事業施策及び財務施策の実現可能性は市場の状況、需要動向等の今後の外部環境の影響を受けること、上述の筆頭株主及び金融機関からの資金調達についても確約されるものではないことから、現時点においては継続企業的前提に関する重要な不確実性が存在するものと認識しております。

なお、連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、継続企業的前提に関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表に反映しておりません。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用方針）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。当該適用指針の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。

（連結損益計算書関係）

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
役員報酬	45,522千円	42,300千円
給料及び手当	194,587	171,391
研究開発費	247,843	232,957

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
	247,843千円	232,957千円

※3 期末棚卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次の棚卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
	11,937千円	63,687千円

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

I 前連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

「II 当連結会計年度（報告セグメントの変更等に関する事項）」に記載のとおりです。

II 当連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

当社グループは、「半導体検査装置事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（報告セグメントの変更等に関する事項）

当社グループは、従来報告セグメントの「半導体検査装置事業」及び報告セグメントに含まない「その他」の2つにセグメントを区分しておりましたが、当連結会計年度より「半導体検査装置事業」の単一セグメントに変更しております。

これは、前連結会計年度に「その他」の事業セグメントに含まれておりましたオーディオ事業を株式会社データゲート（大阪府大阪市北区）に事業譲渡を行ったことにより、「その他」に含まれていた事業がなくなったため、報告セグメントを「半導体検査装置事業」の単一セグメントとして管理することが適切と判断したためであります。

当社の報告セグメントは単一セグメントになることから、前連結会計年度及び当連結会計年度におけるセグメントの情報の記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本	中国	台湾	インドネシア	合計
168,915	32,196	5,744	3,459	210,315

（注）売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
キヤノン株式会社	43,762	半導体検査装置事業
武漢智芯澤科技發展有限公司	30,380	半導体検査装置事業

当連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

（単位：千円）

日本	中国	台湾	インドネシア	合計
239,604	133,622	31,301	2,920	407,449

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
日清紡マイクロデバイス株式会社	78,000	半導体検査装置事業
蔚華電子科技(上海)有限公司	56,521	半導体検査装置事業
合肥宏芯達微電子有限公司	50,837	半導体検査装置事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自 2022年1月1日 至 2022年12月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2023年1月1日 至 2023年12月31日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1株当たり純資産額	37円24銭	37円94銭
1株当たり当期純損失（△）	△19円87銭	△13円85銭

（注）1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
純資産の部の合計額（千円）	1,352,717	1,665,183
純資産の部の合計額から控除する金額（千円）	9,500	9,234
（うち新株予約権（千円））	(9,500)	(9,234)
普通株式に係る期末の純資産額（千円）	1,343,217	1,656,949
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数（株）	36,072,000	43,641,000

3. 1株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)	当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
1株当たり当期純損失（△）		
親会社株主に帰属する当期純損失（△） （千円）	△686,241	△554,572
普通株主に帰属しない金額（千円）	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純損失（△）（千円）	△686,241	△554,572
普通株式の期中平均株式数（株）	34,532,427	40,029,819
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	2020年2月20日取締役会決議による第8回新株予約権 250,000個 (普通株式 250,000株)	2020年2月20日取締役会決議による第8回新株予約権 243,000個 (普通株式 243,000株)

（重要な後発事象）

該当事項はありません。